

Title (en)
METHOD AND MEANS OF FABRICATING A SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE.

Title (de)
VERFAHREN UND MITTEL ZUR HERSTELLUNG EINER VERPACKUNG VON HALBLEITERANORDNUNGEN.

Title (fr)
PROCEDE ET AGENCEMENT DE FABRICATION DE BOITIERS DE DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS.

Publication
EP 0344259 A1 19891206 (EN)

Application
EP 89900040 A 19881026

Priority
US 11522887 A 19871030

Abstract (en)
[origin: WO8904552A1] A semiconductor device assembly is made without a molded package by using a tape having a patterned insulating layer (12) and a conductive layer (14) joined thereto. A semiconductor die (24) is seated on the conductive layer (14) and electrically connected to leads of the patterned conductive layer (14). A body frame (40) is positioned around the die (24) and electrical leads and connections, and an encapsulant material (28) is distributed over the frame (40) and within the frame (40) over the die (24) and electrical leads and connections.

Abstract (fr)
On produit un assemblage de dispositifs semi-conducteurs sans boîtier moulé en utilisant une bande ayant une couche structurée d'isolation (12) reliée à une couche conductrice (14). Un dé semi-conducteur (24) est placé sur la couche conductrice (14) et électriquement connecté à des sorties de la couche (14) conductrice structurée. On place un châssis (40) autour du dé (24), de même que des conducteurs et des connexions électriques, et on distribue un matériau d'enrobage (28) sur le cadre (40), à l'intérieur du cadre (40), sur le dé (24) et sur les conducteurs et connexions électriques.

IPC 1-7
H01L 23/48; H01L 29/52

IPC 8 full level
H01L 21/50 (2006.01); **H01L 23/02** (2006.01); **H01L 23/04** (2006.01); **H01L 23/24** (2006.01); **H01L 23/31** (2006.01); **H01L 23/48** (2006.01); **H01L 23/498** (2006.01); **H01L 25/04** (2006.01); **H01L 25/18** (2006.01)

CPC (source: EP KR)
H01L 21/50 (2013.01 - EP); **H01L 23/3121** (2013.01 - EP); **H01L 23/3135** (2013.01 - EP); **H01L 23/48** (2013.01 - KR); **H01L 23/4985** (2013.01 - EP); **H01L 24/45** (2013.01 - EP); **H01L 24/48** (2013.01 - EP); **H01L 2224/16** (2013.01 - EP); **H01L 2224/16225** (2013.01 - EP); **H01L 2224/32145** (2013.01 - EP); **H01L 2224/45144** (2013.01 - EP); **H01L 2224/48091** (2013.01 - EP); **H01L 2224/73265** (2013.01 - EP); **H01L 2224/92247** (2013.01 - EP); **H01L 2924/00014** (2013.01 - EP); **H01L 2924/01014** (2013.01 - EP); **H01L 2924/01079** (2013.01 - EP); **H01L 2924/14** (2013.01 - EP); **H01L 2924/181** (2013.01 - EP)

Cited by
EP2500423A2; EP2363460A2; EP1997897A1; EP2287320A1; EP2287321A1; WO9920726A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)
WO 8904552 A1 19890518; EP 0344259 A1 19891206; EP 0344259 A4 19910424; JP 2664259 B2 19971015; JP H03503342 A 19910725; KR 890702249 A 19891223; KR 920008256 B1 19920925

DOCDB simple family (application)
US 8803790 W 19881026; EP 89900040 A 19881026; JP 50015888 A 19881026; KR 890701193 A 19890628